

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（深证上[2015]65号）及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2585号核准），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）21,794,871股，发行价格为39.00元/股，募集资金总额为849,999,969.00元，扣除发行费用21,968,674.41元后，募集资金净额为828,031,294.59元。

上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2016年12月15日出具了“众会字(2016)第6361号”《验资报告》。

#### (二) 募集资金使用金额及期末余额

项 目	2019 年度
募集资金净额	827,522,778.35（注）
减：以前年度已使用金额	532,531,066.76
减：本期使用金额	190,715,178.08
减：暂时补充流动资金	80,000,000.00
减：永久补充流动资金（超募资金）	
减：永久补充流动资金（利息收入）	
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	21,961,616.29
尚未使用的募集资金余额	46,238,149.80

注：上表中募集资金净额827,522,778.35元与828,031,294.59元的差异为508,516.24元，此笔差异为非公开发行费用556,325.59元、利息收入47,809.35元所致。

### 二、 募集资金管理情况

#### 1、 募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，对募集资金实行专项存储与使用管理。

2017年1月公司连同保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)分别与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2017年3月，为规范公司募集资金管理，合理降低财务费用，增加存储收益，公司将部分募集资金进行定期存储，为保护中小投资者的权益，公司与东海证券、专户银行在原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管补充协议》。为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于2018年1月30日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，在华夏银行股份有限公司深圳福田支行新设一个募集资金专项账户，并于2018年5月连同保荐机构东海证券与华夏银行深圳福田支行签署了《募集资金三方监管协议》，将原保存在工商银行深圳观澜支行的7,500万元募集资金转存至该募集资金专户实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

同时公司于2018年5月与中国工商银行观澜支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（二）》，协议约定工商银行深圳观澜支行剩余的募集资金继续存放在该银行的募集资金专户。

2018年9月10日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》。公司在中国银行深圳新安支行新设一个募集资金专项账户，并于2018年11月连同保荐机构东海证券与中国银行深圳宝安支行签署了《募集资金三方监管协议》，将原保存在华夏银行深圳龙华支行的1亿元募集资金转存至新设的募集资金专户。另外，同月与华夏银行深圳龙华支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》、《募集资金三方监管协议补充协议（二）》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（三）》，协议约定华夏银行深圳龙华支行剩余的募集资金继续存放在该银行的募集资金专户。

2019年1月10日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募

集资金用途的议案》，公司决定将“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中拟投入晶圆制造生产线和厂房建设的 16,000 万元资金投入至“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”中使用。同时为了将一体电感产品向“小型化、精密化”方向精进，公司推出了更小尺寸的 MPSM 系列电感，故将“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目”。同时为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2019 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，公司在华夏银行深圳龙华支行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在该行用于“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”的 1.6 亿元募集资金转存至新设的募集资金专户，剩余的募集资金继续存放在原募集资金专户。因此公司于 2019 年 3 月与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》、《募集资金三方监管协议补充协议（二）》、《募集资金三方监管协议补充协议（三）》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（四）》。

## 2、募集资金存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额为 46,238,149.80 元，具体情况如下表：

专户银行名称	账号	存储方式	截至 2019 年 12 月 31 日账户余额（元）
中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行	4000026829201085312	活期/存单	287,011.62
中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行	4000026829201085312	信用证	5,443,700.00
中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行	44250100006000000546	活期/存单	496,928.35
华夏银行股份有限公司深圳龙华支行	10867000000836196	活期/存单	5,143,341.88
华夏银行股份有限公司深圳福田支行	10852000000305118	活期/存单	23,279.71
中国银行股份有限公司深圳新安支行	749771032096	活期/存单	33,785,873.39
华夏银行股份有限公司深圳龙华支行	10867000001168900	活期/存单	1,058,014.85
合计	—		

专户银行名称	账号	存储方式	截至 2019 年 12 月 31 日账户余额 (元)
			46,238,149.80

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内募集资金实际情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司本期无募投项目先期投入及置换事项。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 6 月 26 日，公司已将前期用于暂时补充流动资金的 8,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

2019年1月10日召开2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造生产线和厂房建设的16,000.00万元募集资金变更投入至“MPIM小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年04月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会  
2020年04月27日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2019 年度

单位: 万元

募集资金总额		82,803.13				本期投入募 集资金总额	19,071.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		16,000.00				已 累 计 投 入	72,324.62				
累计变更用途的募集资金总额		16,000.00				募 集 资 金 总					
累计变更用途的募集资金总额比例		19.32%				额					
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的 效益	累计实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发 生重大变化
基于 LTCC 基板的终端 射频声表滤波器(SAW) 封装工艺开发与生产 项目	是	37,200.00	21,200.00	1,399.57	10,621.74	50.10	2018-12-31	-443.56	-239.78	否	否
MPIM 及 MPSM 系列一 体电感生产项目	是	28,800.00	44,800.00	17,671.94	44,702.88	99.78	2018-12-31	5,740.22	8,948.38	是	否
补充流动资金	否	16,803.13	16,803.13		17,000.00(注)	101.17	--			不适用	不适用
承诺投资项目小计		82,803.13	82,803.13	19,071.51	72,324.62	87.35	--			不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	--	--	--	--	--	--			--	--
合计	--	82,803.13	82,803.13	19,071.51	72,324.62	87.35	--	5,296.66	8,708.60	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目目前处于逐步放量出货阶段，本报告期实现营业收入3,332.62万元。</p> <p>1) 由于用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足SAW滤波器产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自2017年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。</p> <p>2) 该产品属于射频器件，是手机中的核心元器件，客户认知并熟悉国产供应商有一定过程，客户认证周期长，所以晚于预期。但客户一旦认证，轻易不会变更，这也是该产品的一种优势。</p> <p>3) 遵从科学的发展规律，从低端产品做起，逐步才能做到中高端。低端产品竞争激烈，公司为了打开市场，在产品品质、产品性能上付出了较多的精力和时间。由于采用稳扎稳打、由低到高、逐步拓展的市场策略，故项目早期的营收不明显。</p> <p>4) 该器件的生产加工工艺属于IC的一种特殊小分支，产品研发及流片封装的周期长，故它的投资建设期比被动元器件的投资建设期长。</p> <p>5) 公司智慧园项目建设预计年底竣工，届时会加速SAW的建设。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2017年2月6日，公司召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2019年1月10日召开2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造生产线和厂房建设的16,000.00万元募集资金变更投入至“MPIM小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 1,927.39 万元。2017 年 3 月 26 日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 1,927.39 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次置换出具了专项意见。上述置换已于 2017 年 4 月 7 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将 8,000 万元部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。 2019 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专项账户。

注：补充流动资金的累计投入金额包含期间银行产生的利息。



附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2019 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更前项目拟投入募集资金总额	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	累计实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器 (SAW) 封装工艺开发与生产项目	基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器 (SAW) 封装工艺开发与生产项目	37,200.00	21,200.00	1,399.57	10,621.74	50.10	2018-12-31	-443.56	-239.78	否	否
MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目	MPIM 小尺寸系列电感生产项目	28,800.00	44,800.00	17,671.94	44,702.88	99.78	2018-12-31	5,740.22	8,948.38	是	否
<b>合计</b>	--	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>19,071.51</b>	<b>55,324.62</b>	<b>83.83</b>	--	<b>5,296.66</b>	<b>8,708.60</b>	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>2017 年 2 月 6 日, 公司召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》, 为便于公司统一管理, 降低运营成本, 提高管理效率, 公司将非公开发行募集资金投资项目中“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器 (SAW) 封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区, 实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部, 公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。</p> <p>2017 年 11 月 16 日, 公司召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 决定将公司非公开发行股票募投项目中“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器 (SAW) 封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”达到预定可使用状态的时间自 2017 年 12 月 31 日延至 2018 年 12 月 31 日, 公司独立董事、监事会、保荐机构对本次调整出具了专项意见。</p>										

	<p>2019年1月10日召开2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造生产线和厂房建设的16,000万元募集资金变更投入至“MPIM小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”。</p>
<p>未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)</p>	<p>基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目目前处于逐步放量出货阶段，本报告期实现营业收入3,332.62万元。</p> <p>1) 由于用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足SAW滤波器产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自2017年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。</p> <p>2) 该产品属于射频器件，是手机中的核心元器件，客户认知并熟悉国产供应商有一定过程，客户认证周期长，所以晚于预期。但客户一旦认证，轻易不会变更，这也是该产品的一种优势。</p> <p>3) 遵从科学的发展规律，从低端产品做起，逐步才能做到中高端。低端产品竞争激烈，公司为了打开市场，在产品品质、产品性能上付出了较多的精力和时间。由于采用稳扎稳打、由低到高、逐步拓展的市场策略，故项目早期的营收不明显。</p> <p>4) 该器件的生产加工工艺属于IC的一种特殊小分支，产品研发及流片封装的周期长，故它的投资建设期比被动元器件的投资建设期长。</p> <p>5) 公司智慧园项目建设预计年底竣工，届时会加速SAW的建设。</p>
<p>用闲置募集资金暂 时补充流动资金 情况</p>	<p>2018年6月27日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将8,000万元部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期归还至募集资金专户。</p> <p>2019年6月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2019年8月29日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过8,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期归还至募集资金专户。</p>
<p>变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明</p>	<p>不适用。</p>